**[加速科技杯](http://univ.ciciec.com/nd.jsp?id=567" \l "_jcp=1)**

**一、杯赛题目：芯片应用与产业链创新成果**

**二、参赛要求：A组、B组**

**三、赛题内容：**

1. 参赛项目的主体部分为芯片创新应用成果，应用领域不限，可包括但不限于网信系统、汽车电子、智能终端、5G、物联网，信息安全等方向；

2. 参赛项目也可以为半导体产业链上的创新成果，可包括但不限于如下方向：

     （1）芯片创新应用成果，应用领域不限，可包括但不限于网信系统、汽车电子、智能终端、5G、物联网，信息安全等方向；

     （2）半导体产业链上的创新成果，可包括但不限于半导体材料、器件、设备、工艺、EDA工具等；

     （3）半导体测试设备的功能实现、先进集成电路芯片商业测试案例开发；

3. 创新成果应当在技术上具备创新性或在应用上具备市场价值；

4. 参赛团队成员应当主导或深入参与本创新成果的开发，参赛团队经过了本项目成果所有方的授权。

**四、杯赛阶段及提交内容：**

**1. 中期汇报**

提交简短的项目内容和进展说明，应当包括创新成果简介，主要技术指标和应用领域，以及当前开发进度等。

**2. 初赛**

(1) 成果技术报告（必须）：

包含创新成果的技术原理分析、具体架构和设计参数、设计实现、测试结果、演示实物和视频等；

(2) 商业计划书（可选）：

如果创新成果已经具备一定的市场化和产品化潜力，推荐撰写商业计划书。可包含如下内容：公司／团队介绍、技术与产品、市场分析、竞争分析、市场营销、投资说明、投资报酬、风险分析、组织管理、经营预测、财务分析等；

(3) 专利论文：

提交本项目已经申请或正在申请的专利及论文列表。

**3. 分赛区决赛**

(1) 汇报PPT：包括成果介绍、技术分析、商业价值分析以及项目进展等；

(2) 成果技术报告（同上）；

(3) 商业计划书（同上）；

(4) 专利论文（同上）；

(5) 视频或现场演示。

**4. 全国总决赛**

(1) 汇报PPT：包括成果介绍、技术分析、商业价值分析以及项目进展等；

(2) 成果技术报告（同上）；

(3) 商业计划书（同上）；

(4) 专利论文（同上）；

(5) 视频或现场演示。

**五、评分标准：**

本杯赛将综合考虑项目的技术创新性和项目市场潜力及可行性，只要项目具备上述单个或多个优势，均有机会获得高分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大项 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
| 技术方面（50分） | 技术创新性 | 25分 | 技术方向的创新点以及相对同行的领先程度 |
| 项目难度和成熟度 | 10分 | 整个项目的复杂度、工作量以及技术的成熟度 |
| 项目完成度 | 15分 | 成果到实现实际应用的距离 |
| 商业方面（40分） | 市场价值 | 20分 | 项目所在赛道的市场规模和项目本身的产业化前景 |
| 投资价值 | 20分 | 项目是否具备竞争优势，带头人及团队的能力，当前知识产权价值等 |
| 现场表现（10分） | 演讲能力 | 5分 | 现场演讲和提问环节的整体表现 |
| 文档质量 | 5分 | 所展示的PPT以及商业计划书项目资料的质量 |

**六、注意事项**

1. 大赛组委会和杯赛企业对参赛作品的提交材料拥有展示权；

2. 大赛联合投资机构搭建的高校集成电路创新孵化平台将优选出具备技术领先性或市场潜力的优秀项目，给予后续的技术、资金、行业资源和落地支持；

3. 已经参加过集创赛创新赛道的作品，如果无重大创新或改进，不能重复参赛。